

高云的产品变更通知 (GPCN)

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此文件是为了提醒客户关注此次变更。此次变更对 WLCSP72 封装产品的锡球进行了变更，以满足更多的客户应用要求。

描述

WLCSP72 封装产品锡球由 SAC305 变更为 SAC405。

变更前	1. 锡球型号：SAC305 2. 锡球成分：Sn 96.5% / Ag 3.0% / Cu 0.5%
变更后	1. 锡球型号：SAC405 2. 锡球成分：Sn 95.5% / Ag 4.0% / Cu 0.5% 3. 锡球性能：润湿性、机械强度、热疲劳性能更好

受影响的产品

GW1N-LV4CS72

客户影响

此变更未涉及产品外形、尺寸、功能、可靠性、质量及安全的变更，对客户应用无影响。

认证数据

高云已经完成并成功通过了所有必要的认证，可根据要求提供验证数据。

关键日期

高云将在变更发布 90 天后开始市场中供应锡球为 SAC405 的 WLCSP72 封装产品，锡球为 SAC305 的 WLCSP72 封装产品库存消耗完成后将不再安排生产与供货。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

客户批准

客户名称: _____

授权代表: (签字) _____

批准日期: _____

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2025/06/17	1.0	初始版本。

版权所有 © 2024 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。